

PLACA DE ALTA TEMPERATURA BAMBU PARA P1P, P1S, X1C Y X1E

FAP002+FAP003



Descripción:

Placa Bambu para altas temperaturas, compatible con las impresoras 3D Bambu Lab P1P, P1S, X1C y X1E.

Un lado: Placa de alta temperatura de bambú = Lámina de alta temperatura + Placa de ingeniería de bambú El otro lado: Placa de ingeniería de bambú...



1.Placa de alta temperatura de bambu

Tenga en cuenta que es posible que sea necesario ajustar otros parámetros del slicer según el modelo impreso y los requisitos del filamento.

Materiales	Temperatura de la cama caliente	¿Se necesita barra de pegamento?	¿Se quitó la placa de cubierta de vidrio superior?
PLA/PLA-CF/PLA-GF	45 ~ 60 °C	No	Sí
ABS (no para A1 mini)	90 ~ 100 °C	No	No
PETG/PETG-CF	60 ~ 80 °C	No	No
PET-CF (no para A1 mini)	80 ~ 100 °C	No	No
TPU	35 ~ 45 °C	Sí	Sí
ASA (no para A1 mini)	90 ~ 100 °C	No	No
PVA	45 ~ 60 °C	No	Sí
PC/PC-CF (no para A1)	90 ~ 110 °C	Sí	No

mini)			
PA/PA-CF/PAHT-CF (no para A1 mini)	90 ~ 110 °C	Sí	No

Beneficios:

- Funciona mejor con la mayoría de los filamentos de impresión 3D.
- Funciona bien con la calibración automática del caudal y no interfiere con el LIDAR.
- Textura suave en la superficie de la impresión.
- Excelente adherencia y fácil remoción de la impresión.
- Puede ser reemplazado por el usuario

Desventajas:

- No se puede utilizar sin calentar la superficie de impresión.
- Puede ser más frágil en comparación con la placa de ingeniería o la placa PEI texturizada.
- Es necesario abrir la placa de cubierta de vidrio superior o la puerta de vidrio frontal para filamentos con una temperatura de transición vítrea baja.

2. Placa de ingeniería de bambú:

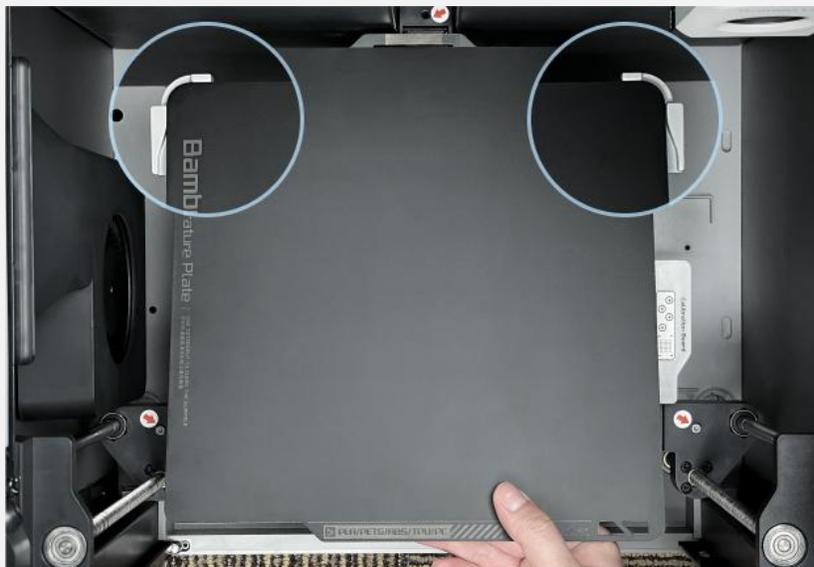
Materiales	Temperatura de la cama caliente	¿Se necesita barra de pegamento?	¿Se quitó la placa de cubierta de vidrio superior?
TPU	30 ~ 35 °C	Recomendado	No
PETG/PETF-CF	70 ~ 80 °C	Recomendado	Sí
PET-CF	70 ~ 80 °C	Recomendado	Sí
ABS	100 ~ 110 °C	Sí	No
PC/PC-CF	100 ~ 110 °C	Sí	No
PA/PA-CF/RUTA-CF	100 ~ 110 °C	Sí	No

Consideraciones:

- Las variaciones en el color y el brillo de la apariencia de la placa de ingeniería y la eliminación de las áreas metálicas expuestas son solo ajustes menores para optimizar el proceso de producción y la calidad de la superficie. Si el revestimiento permanece en la boquilla cuando se limpia, se calentará y se derretirá antes de imprimir el modelo. Dichos cambios no afectan la nivelación, el lidar, la adhesión ni el rango de uso. ¡Puede comprar con confianza!
- Antes de realizar la nivelación automática, es necesario frotar repetidamente la boquilla en el área de limpieza especial de la placa de impresión para eliminar por completo cualquier material residual en la punta de la boquilla. El revestimiento en el área de limpieza especialmente diseñada se desgastará gradualmente con el tiempo. Esto es normal y no afecta la calidad de impresión ni la vida útil de la boquilla, por lo que no hay necesidad de preocuparse por problemas de calidad.
- Bambu Lab recomienda utilizar únicamente el pegamento oficial de Bambu Lab en la placa de construcción y no se hace responsable de ningún daño causado a las placas como resultado del uso de pegamento de terceros en las placas de construcción.
- Limpie periódicamente la superficie de impresión con jabón lavavajillas y agua caliente para eliminar cualquier resto de polvo o grasa, que podría provocar una mala adherencia. El alcohol isopropílico también puede funcionar, pero la mejor solución para limpiar la placa es lavarla para garantizar el mejor rendimiento.
- Espere siempre unos minutos antes de retirar los modelos impresos para permitir que la placa se enfríe y facilitar la extracción de la impresión. Esto evita que se dañe la placa y garantiza una larga vida útil del producto.
- La placa PEI lisa de alta temperatura se considera una pieza consumible, que se degradará con el tiempo. La garantía solo cubrirá defectos de fabricación, no daños estéticos como rayones, abolladuras o grietas. Las láminas defectuosas al momento de la entrega son las únicas cubiertas por la garantía.

Pasos de instalación:

Paso 1: Alinee la placa con los puntos fijos de la plataforma con el nombre de la placa mirando hacia usted.



Paso 2: Bajar la placa y asegurarla a la plataforma magnética.



Especificaciones del producto:

Descripción	Unidad	
Material	-	Lámina de PEI lisa + acero para resortes + revestimiento de ingeniería
Resistencia a la temperatura superficial	°C	Hasta 120
Espesor del acero de resorte flexible	mm	0,4
Espesor de la etiqueta de la placa de alta temperatura	mm	0,03
Tamaño de impresión utilizable	mm	256 x 256
Tamaño del paquete	mm	290 x 290 x 4
Peso del paquete	g	450
Color	-	Negro

AG Electrónica SAPI de CV
República de El Salvador 20 Piso 2, Centro Histórico, Centro, 06000 Ciudad de México, CDMX
Teléfono: 55 5130 7210

Realizó	Francisco Javier Hernández Ramos
Revisó	Ing. Luz Fernanda Domínguez Gómez
Fecha	21/01/2025

